BA-100

B系列X射线荧光测厚仪

B系列的大内部腔体，开槽式设计，适用于大部分应用场合，是一款通用型产品。

- ■镀层厚度测量
- ■元素分析
- ■电镀液分析

技术参数 | Technical Parameters

元素测量范围	原子序号从Al铝（13）到U铀（92）	
分析能力	镀层：最多同时测5层（4层镀层+基材） 成份：最多同时测定25种元素	
X射线管	微聚焦铍窗钨W靶射线管，X射线由上往下发射 标定功率50瓦，最高电压50千伏，最大电流1.0毫安 高效散热钢管体	
探测器类型及分辨率	Si-PIN半导体探测器　可选：SDD半导体探测器 分辨率优于190eV　分辨率优于135eV	
滤波器	4个自动切换铝（Al)滤波片，降低X射线背景噪音	
准直器	BA-100-SFF(单准直器)	BA-100-MFF（多准直器）
	标配：　0.2mm 可选：　0.3mm 　　0.6mm	标配：0.1，0.2,0.3,0.6　mm 可选：0.1,0.15,0.2,0.3　mm 0.1,0.2,0.2,1.5　mm 0.05x0.05,0.1,0.2,0.3　mm 0.05x0.25,0.1,0.2,0.3　mm 0.025x0.25,0.1,0.2,0.3　mm
视像系统	标配：30倍高清相机　可选：45倍高清相机 数字放大：1-4倍 聚焦方式：手动镭射聚焦，自动镭射聚焦，光学扫描聚焦三种方式	
Z轴行程	132mm	
XY平台	固定	
外部尺寸 内腔尺寸 开槽高度	450（高）x450(宽）x600(深）mm 140(高）x310（宽）x335（深）mm 15mm	
工作环境	电源：150W，100~240V，47~63Hz 温度：20~25℃，相对湿度：＜98%，无冷凝	
净重	34Kg	

BA-100

P系列X射线荧光测厚仪

P系列配置高精度可编程XY平台，可编程序进行多点自动测量。适用电路板，连接器，半导体等行业。

- ■镀层厚度测量
- ■自动Z轴控制
- ■元素分析
- ■可编程XY台面
- ■电镀液分析

技术参数 | Technical Parameters

元素测量范围	原子序号从Al铝（13）到U铀（92）	
分析能力	镀层：最多同时测5层（4层镀层+基材） 成份：最多同时测定25种元素	
X射线管	微聚焦铍窗钨W靶射线管，X射线由上往下发射 标定功率50瓦，最高电压50千伏，最大电流1.0毫安 高效散热钢管体	
探测器类型及分辨率	Si-PIN半导体探测器　可选：SDD半导体探测器 分辨率优于190eV　分辨率优于135eV	
滤波器	4个自动切换铝（Al)滤波片，降低X射线背景噪音	
准直器	BA-100-MFF（多准直器）	
	标配：0.1，0.2,0.3,0.6　mm 可选：0.1,0.15,0.2,0.3　mm 0.1,0.2,0.2,1.5　mm 0.05x0.05,0.1,0.2,0.3　mm 0.05x0.25,0.1,0.2,0.3　mm 0.025x0.25,0.1,0.2,0.3　mm	
视像系统	标配：30倍高清相机　可选：45倍高清相机 数字放大：1-4倍 聚焦方式：手动镭射聚焦，自动镭射聚焦，光学扫描聚焦三种方式	
Z轴行程	132mm	
XY轴行程 XY台面尺寸	BA-100-P	BA-100-E
	152x127mm 标配：381x340mm 可选：600x600mm	254x254mm 635x635mm
XY精确度	±10μ m	
外部尺寸 内腔尺寸 开槽高度	450（高）x450(宽）x600(深）mm 140(高）x310（宽）x335（深）mm 15mm	
工作环境	电源：150W，100~240V，47~63Hz 温度：20~25℃，相对湿度：＜98%，无冷凝	
净重	42Kg	50Kg